

关于为防止产品的篡改而粘贴包装封条的通知 (MELSEC iQ-R/MELSEC iQ-F系列)

■ 出版年月

2021年11月 (2024年2月修订C版)

■ 相关机型

FX5U-32MR/DS、FX5U-32MR/ES、FX5U-32MT/DS、FX5U-32MT/DSS、FX5U-32MT/ES、FX5U-32MT/ESS、FX5U-64MR/DS、FX5U-64MR/ES、FX5U-64MT/DS、FX5U-64MT/DSS、FX5U-64MT/ES、FX5U-64MT/ESS、FX5U-80MR/DS、FX5U-80MR/ES、FX5U-80MT/DS、FX5U-80MT/DSS、FX5U-80MT/ES、FX5U-80MT/ESS、FX5UC-32MR/DS-TS、FX5UC-32MT/D、FX5UC-32MT/DSS、FX5UC-32MT/DSS-TS、FX5UC-32MT/DS-TS、FX5UC-64MT/D、FX5UC-64MT/DSS、FX5UC-96MT/D、FX5UC-96MT/DSS、R00CPU、R01CPU、R02CPU、R04CPU、R04ENCPU、R08CPU、R08ENCPU、R16CPU、R16ENCPU、R32CPU、R32ENCPU、R120CPU、R120ENCPU

感谢您继续支持三菱电机MELSEC iQ-R/MELSEC iQ-F系列可编程控制器。

为了防止出厂后的软件篡改等，在产品包装箱上粘贴封条，以提高硬件的安全性。

此外，与以往产品相比，一般规格、性能规格、功能及外形尺寸不会因本次变更而发生变更。

关于R00CPU、R01CPU、R02CPU、R04CPU、R04ENCPU、R08CPU、R08ENCPU、R16CPU、R16ENCPU、R32CPU、R32ENCPU、R120CPU、R120ENCPU，变更了包装形态。详细内容请参照下述技术简讯。

📖关于为防止产品的篡改而变更包装箱的通知 (MELSEC iQ-R系列) (FA-CN-0384)

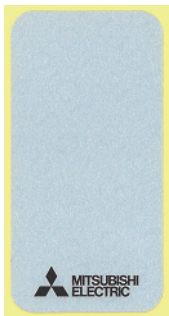

1 变更内容

在对象机型的包装箱开口处粘贴封条。

1.1 封条的外观及规格





根据对象模块的生产时期，粘贴的封条将有所不同。

粘贴的封条外观及规格如下所示。

粘贴期间	外观	尺寸	规格
2021年12月~2022年2月		20mm×40mm	<ul style="list-style-type: none"> 在封条表面上显示企业标志。 由于是留字型，因此揭开封条后包装箱上将留下文字“VOID”。
2022年3月及以后		25mm×55mm	<ul style="list-style-type: none"> 在封条表面上显示企业标志。 由于使用了强力胶，因此揭开封条后将留下开封痕迹。

1.2 封条的粘贴位置及包装外观

2022年3月及以后生产产品的粘贴位置及包装外观如下所示。关于2022年2月及以前生产的模块，虽然粘贴的封条不同，但是粘贴位置及包装外观相同。

对象模块型号	粘贴位置、包装外观	
FX5U-32MR/DS、FX5U-32MR/ES、FX5U-32MT/DS、FX5U-32MT/DSS、FX5U-32MT/ES、FX5U-32MT/ESS、FX5U-64MR/DS、FX5U-64MR/ES、FX5U-64MT/DS、FX5U-64MT/DSS、FX5U-64MT/ES、FX5U-64MT/ESS、FX5U-80MR/DS、FX5U-80MR/ES、FX5U-80MT/DS、FX5U-80MT/DSS、FX5U-80MT/ES、FX5U-80MT/ESS、FX5UC-32MR/DS-TS、FX5UC-32MT/D、FX5UC-32MT/DSS、FX5UC-32MT/DSS-TS、FX5UC-32MT/DS-TS、FX5UC-64MT/D、FX5UC-64MT/DSS、FX5UC-96MT/D、FX5UC-96MT/DSS	盖子的左侧 	底部 
R00CPU、R01CPU、R02CPU	盖子的左侧 	
R04CPU、R08CPU、R16CPU、R32CPU、R120CPU	盖子的左侧 	

FA-CN-0359-C

对象模块型号	粘贴位置、包装外观	
R04ENCPU、R08ENCPU、R16ENCPU、R32ENCPU、R120ENCPU	盖子的左侧 	底部 

2 对象机型

品名	型号
MELSEC iQ-F系列CPU模块	FX5U-32MR/DS、FX5U-32MR/ES、FX5U-32MT/DS、FX5U-32MT/DSS、FX5U-32MT/ES、FX5U-32MT/ESS、FX5U-64MR/DS、FX5U-64MR/ES、FX5U-64MT/DS、FX5U-64MT/DSS、FX5U-64MT/ES、FX5U-64MT/ESS、FX5U-80MR/DS、FX5U-80MR/ES、FX5U-80MT/DS、FX5U-80MT/DSS、FX5U-80MT/ES、FX5U-80MT/ESS、FX5UC-32MR/DS-TS、FX5UC-32MT/D、FX5UC-32MT/DSS、FX5UC-32MT/DSS-TS、FX5UC-32MT/DS-TS、FX5UC-64MT/D、FX5UC-64MT/DSS、FX5UC-96MT/D、FX5UC-96MT/DSS
MELSEC iQ-R系列CPU模块	R00CPU、R01CPU、R02CPU、R04CPU、R04ENCPU、R08CPU、R08ENCPU、R16CPU、R16ENCPU、R32CPU、R32ENCPU、R120CPU、R120ENCPU

3 变更时期

2021年12月生产的产品开始，将包装变更为了粘贴留字型封条的形态。
之后，2022年3月生产的产品开始，将包装变更为了粘贴使用强力胶的封条的形态。

修订记录

副编号	修订年月	修订内容
A	2021年11月	第一版
B	2022年2月	补充记载了封条No. 2的规格、粘贴位置、变更时期。
C	2024年2月	补充记载了有关MELSEC iQ-R CPU模块的包装形态变更的内容。 从粘贴位置的说明部分删除了变更前的封条(No. 1)。

商标

The company names, system names, and product names mentioned in this technical bulletin are either registered trademarks or trademarks of their respective companies.

In some cases, trademark symbols such as ‘™’, or ‘®’, are not specified in this technical bulletin.